

## KDB TechConnect Day 開催案内

# 戦略的投資誘致・提携希望企業募集について

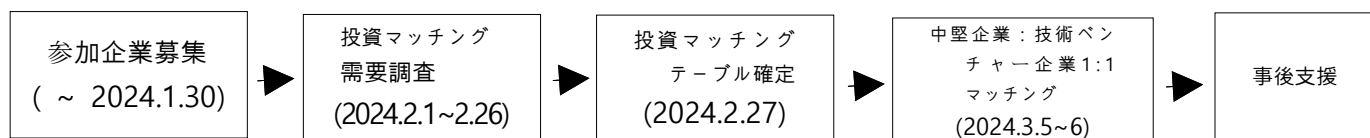
韓国素材部品装備投資機関協議会、(株)ゼータプランインベスト、KDB産業銀行は国内素材・部品・装備産業競争力強化の一環として、大手・中堅企業のネットワーク、資金とスタートアップ技術、アイデアが合わさった戦略的提携を支援するため、共同で“KDB TechConnect Day”を開催いたします。戦略的投資誘致または提携を希望される、**素材・部品・装備**、ヘルスケア技術のスタートアップ企業は、大手・中堅企業の投資希望技術分野を参照し、添付した申込書を通じ、多くの方の参加をお願い致します。

### □ 大手・中堅企業の投資希望技術分野

参加企業分野	投資及び協力希望技術分野
素材・化学 (イノックス, チョグアンペイント等)	1. 半導体、二次電池、次世代ディスプレイなどに使用される素材及びケミカル 2. 能性コーティング素材、粘、接着材用素材及びエコペイント
部品・装備 (ピーエイチシー、ジンソンティーイーシー、HLホールディングス 等)	1. スマートフォン、ディスプレイ、二次電池、自動車用電子部品 2. ロボット及び人工知能を活用した自律走行
ヘルスケア ( Daewon Pharmaceutical、Huons Global、JWホールディングスなど )	1.創薬パイプライン可能な物質 2.医療機器、デジタルヘルスケア 3.健康機能食品、フードテック 4. 先端バイオ医薬品製造のための素材・部品・装備

※ ミーティング希望企業がない場合、参加辞退の可能性あり

## KDB TechConnect Day 推進スケジュール



- お問合せ先 韓国技術ベンチャー財団 東京事務所(03-3436-1396. songktvfjp@gmail.com)
- 申請先 添付した申請書の作成後 songktvfjp@gmail.comにて e-mail 受付
- 面談日時 2024年3月5日~6日 10時~18時(1回 面談は約1時間を予定)
- 面談場所 産業銀行本店1階顧客接見室(汝矣島国会議事堂駅付近)
- 協力機関 韓国技術ベンチャー財団、韓国発明振興会、(株)エスワイピー
- 注意事項 お越しになる際は、なるべく公共交通をご利用ください。